

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Hipotesis.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Material Solder.....	9
2.1.1 Timah Putih (Sn).....	10
2.1.2 Tembaga (Cu).....	11
2.1.3 Silver (Ag).....	13
2.1.4 Bismuth (Bi).....	14
2.2 Uji Kekerasan.....	16
2.2.1 <i>Microhardness</i>	16
2.2.2 <i>Vickers</i>	17
2.3 Uji Geser	18
2.4 <i>Metallography</i>	18
2.5 <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	20
2.5.1 Cara kerja <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	21
2.6 Berat Jenis	21
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Studi Literatur dan Jurnal.....	23
3.2 Diagram Alir Penelitian	24

3.3	Proses pembuatan paduan Sn-0,7Cu-Ag dan Bi	25
3.4	Alat dan Bahan yang digunakan	25
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Perbandingan dari Hasil Pengukuran Berat Jenis.....	26
4.2	Hasil dari Pengukuran Temperatur Leleh pada Paduan Sn-Cu-Ag.....	27
4.3	Hasil dari Pengukuran Kekerasan pada Paduan Sn-Cu-Ag.....	27
4.4	Hasil dari Pengukuran Pengujian Geser pada Paduan Sn-Cu-Ag.....	28
4.5	Grafik Perbandingan antara Data 1 dan Data 2 Jenis Paduan Sn-Cu-Ag..	28
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	32
5.2	Saran.....	32